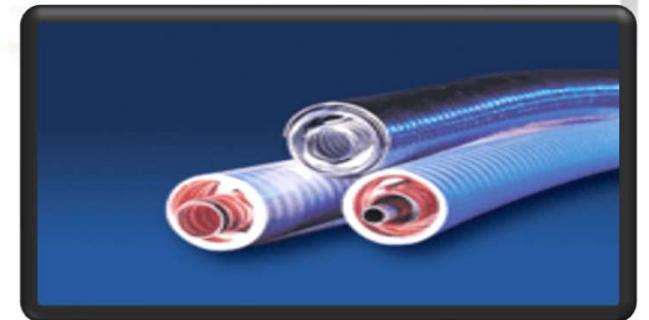




(주)에버텍엔터프라이즈

회 사 소 개



(주) 에버텍엔터프라이즈
Evertch Enterprise Co., Ltd.

01 개요

02 사업 소개

03 Appendix

01

개 요

- ❖ 회사 소개
- ❖ 연 혁
- ❖ 조직
- ❖ 경영
- ❖ 서비스
- ❖ 고객사

회사 소개

회사명	(주) 에버텍엔터프라이즈	대표이사	한태수 (韓泰洙)
업종	- 전기전자용 소재 제조 및 판매 - 무역	자본금	20억원
설립일	2000년 1월 5일	매출액	151억원(2021년 기준)
종업원수	57명	홈페이지	www.kevertech.com
사업분야	제조 - 전기전자용 소재 무역 - VBC LN ₂ (액체질소) Piping System		
주소	경기도 화성시 동탄면 동탄산단 2길 7-9		
연락처	TEL 031-718-3818 FAX 031-5183-4411 E-MAIL sales@kevertech.com		

2020	6	SK Hynix 기술혁신기업 선정
2019	9	일하기 좋은 뿌리기업 (산업통상자원부)
	1	뿌리기술 전문기업 (중소벤처기업부) 청년친화 강소기업 선정 (고용노동부)
2018	6	대만 판매 Agent 계약
2017	12	동탄 사옥 신축 및 이전
	4	중국 판매 Agent 계약
2016	5	모범 중소기업인 대통령 표창
2015	11	성남시 중소기업인 대상 수상
	7	동탄 사옥 부지 토지 매입 (4,027.1m ²)
2013	12	수출 유망중소기업 지정 (경기지방중소기업청)
	11	벤처기업 “3백만불 수출의 탑” 수상 (한국무역협회)
	9	취업하고 싶은 기업 선정 (이노비즈협회)
2010	2	Hitech(SK Hynix 중국(Wuxi)합작법인) 수출
2007	11	경기도 유망중소기업 인증
	9	기술혁신형 중소기업 인증 (이노비즈협회)
2006	12	ISO9001 / 14001 인증
	5	공장 등록
	4	기업 부설 연구소 설립 (소재사업 시작)
2001	6	SK Hynix 협력업체 등록
	4	삼성전자 협력업체 등록
2000	1	법인 설립



- 연구소
- 품질팀
- 제조기술팀
- 영업팀
- VBC팀
- 경영지원실

전체인원 : 57명
 연구원 : 24명

High portion in Development

We always think customer support is our first priority to improve customer's satisfaction on our service. Based on this thinking, we continuously increase Development portion of our human resource

| 인증서



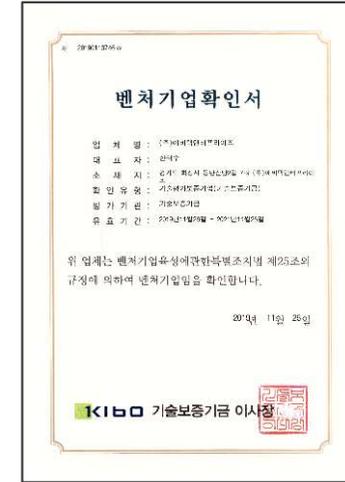
IATF 16949:2016



ISO 14001:2004



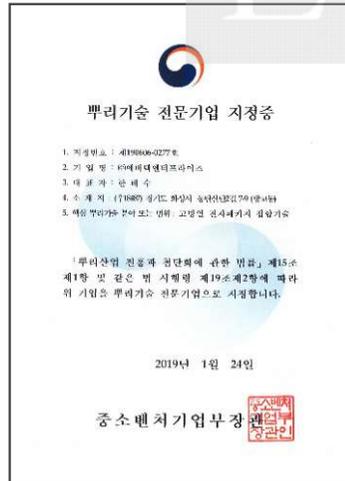
기술혁신형 중소기업 확인서



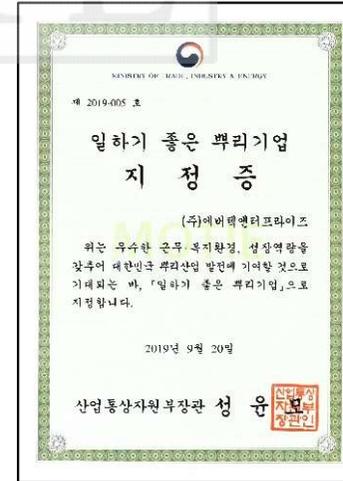
벤처기업확인서



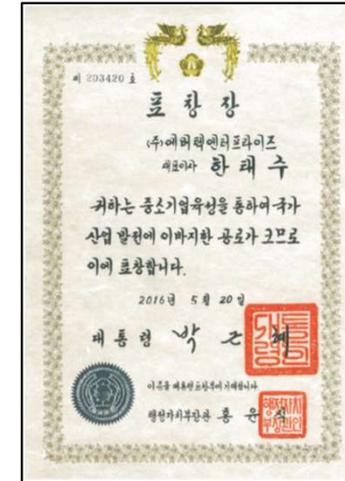
취업하고싶은기업 인증서



뿌리기술 전문기업 지정증



일하기 좋은 뿌리기업 지정증



모범중소기업인 대통령 표창

등록 19건

내 용	일 자	번 호
1. 무세척 플렉스 조성물	2018.12.24	10-2018-0168777
2. 디태치 모드 특성이 강화된 다이본딩용 실리콘 조성물	2015.05.22	10-2015-0072002
3. 인장 및 흡습특성이 강화된 잉곳 마운팅 2액형 접착제 조성물	2013.03.25	10-2013-0031552
4. 바이오매스로부터 합성된 친환경수지로 제조한 잉곳 마운팅 2액형 접착제 조성물	2013.03.25	10-2013-0031551
5. 흡습 내성이 우수한 경화형 다이 접착제 조성물	2013.01.04	10-2013-0000977
6. 잉곳 마운팅 접착제 조성물	2012.03.28	10-2012-0031560
7. 반응성이 향상된 LED용 내열 실리콘 경화 조성물	2012.03.28	10-2012-0031581
8. 일액형 자기접착성 폴리실록산 조성물	2012.03.28	10-2012-0031556
9. 발광 다이오드용 폴리유기실리콘 조성물	2011.07.27	10-2011-0074574
10. 반도체 장치용 폴리유기실리콘 조성물	2011.07.27	10-2011-0074557
11. 발광 다이오드 봉지재용 열경화성 실리콘 조성물	2010.01.19	10-2010-0004872
12. 광반도체칩 접착용 투명 실리콘 조성물	2010.01.19	10-2010-0004889
13. 페이스-다운 실장형 반도체에 적용 가능한 다이 본딩용 실리콘 조성물	2010.01.19	10-2007-0004864
14. 상온 경화형 이액형 에폭시 조성물	2007.11.28	10-2007-0122299
15. 저습성 및 고신뢰성을 가지는 다이 접착용 전기전도성 접착 조성물	2007.11.28	10-2007-0122300
16. B-stage 온도조건의 변동폭을 허용 하는 B-stage 에폭시 접착제 조성물	2007.11.28	10-2007-0122301
17. 내습성 및 흐름성이 우수한 언더필용 하이브리드 에폭시 조성물	2007.11.28	10-2007-0122303
18. 내습성 및 흐름성이 우수한 언더필용 하이브리드 에폭시 조성물	2007.11.28	10-2007-0122302
19. 열전도성이 우수한 언더필용 에폭시 조성물	2007.11.28	10-2007-0122298

제
조

Semiconductor

Domestic



Overseas



LED

Domestic

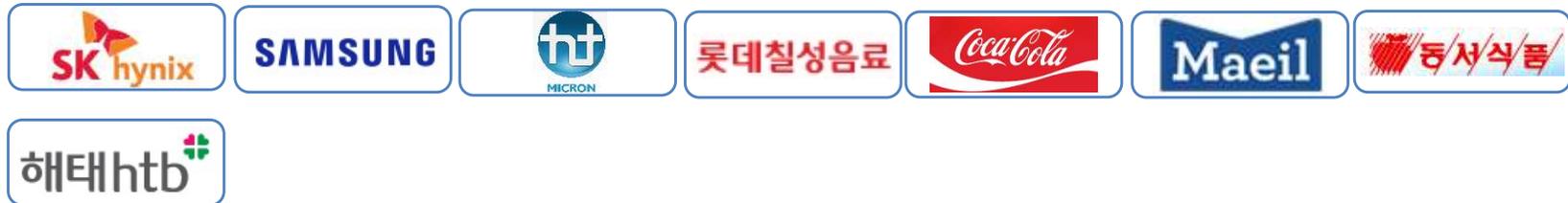


Overseas



무
관

VBC



02

사업 소개

- ❖ Business Portfolio
- ❖ Electronic Material(Adhesive)
- ❖ LN₂ (액체질소) Piping System

Business portfolio



Electronic Material

Various adhesive for semiconductor, LED components with specific cost reduction plan to satisfy customer's needs



LN₂ Piping System

From VBC, Provide total solution for LN₂ System

Adhesive - Semiconductor

1) Adhesive for BGA PKG : Conductive

Item	Competitor	Product	Application	Customer
Ag paste	84-1-LMI-SR4 (H社)	A505, AP2500	SOP/TSSOP/TSOP	S, S社 (Korea)
	CRM1085A(S社)	A506	QFN	A社 (Korea, Philippines)
	3230(H社)/4900GC(H社)	AP4200	QFP/QFN	S, H社 (Korea) A社 (Korea, Philippines)
	2100A(H社)	AP4700	PBGA/FBGA	S社 (Korea)
	2030SC(H社)	AP4400	Power PKG	I社 (Korea)

2) Adhesive for BGA PKG : Non-conductive

Item	Competitor	Product	Application	Customer
B-stage(Epoxy)	SA series(H社)	HE-SP-2	BOC SDP/DDP	H,A,W,S,H,S社 (Korea) H,T社 (China)
A-stage(Silicone)	DA6633/DA6570(D社)	HE-STA-2 AF8104	BOC	
Epoxy	2025D(H社) CRM1575(S社)	AP8310 AP8400H	PBGA/FBGA /QFN	A, H, S社 (Korea)

Electronic Material - Solder flux & TIM

1) SF (Solder Flux)

Item	Competitor	Product	Application	Customer
Solder Flux	WF6317(S社)	SP6900	BGA/FOWLP/Possum Solder Ball Mounting	H社 (Korea) H社 (China)
		SP6900F	FCBGA/CSP Flip chip attach	A社 (Korea/Taiwan)
	WS3401/3401A(I社)	SP6100	Wafer bumping	
		SP6100A		
	SC 5R(I社)	SP7100		
	901-K5(S社)	SP7000	PoP/FCBGA 1st & 2nd PKG attach / Flip chip attach	

2) TIM (Thermal Interface Materials)

Item	Competitor	Product	Application	Customer
TIM	SE4450(D社)	AP3200	FBGA Heat slug & Lid attach	A, S, S, H社 (Korea)

Adhesive - LED & etc.

1) LED Package

Item	Competitor	Product	Application	Customer
Conductive	668-3S(P社)	AP2400	Zener bonding	L, S, L社 (Korea/China) D, I社 (Korea)
	10BFN(P社)	AP2510	Chip/Zener bonding	
	CT288 Series(K社)	AP2600		
Silicone Clear D/A Adhesive	KER-3000-M2(S社)	CL5610	Chip bonding	
Dam material	KER-2000-DAM(S社)	DP9100A	COB	
Encapsulant	OE6630(D社)	EC4506C / EC4507	Encapsulant	

2) etc (Ingot / STB)

Item	Competitor	Product	Application	Customer
Ingot	Stycast(H社) Q-Bond(N社)	S351-J S500-J	Beam to Plate bonding	L社 (Korea)
STB	-	A301	Chip Protection	H, T, L社 (Korea)

LN₂ (액체질소) Piping System



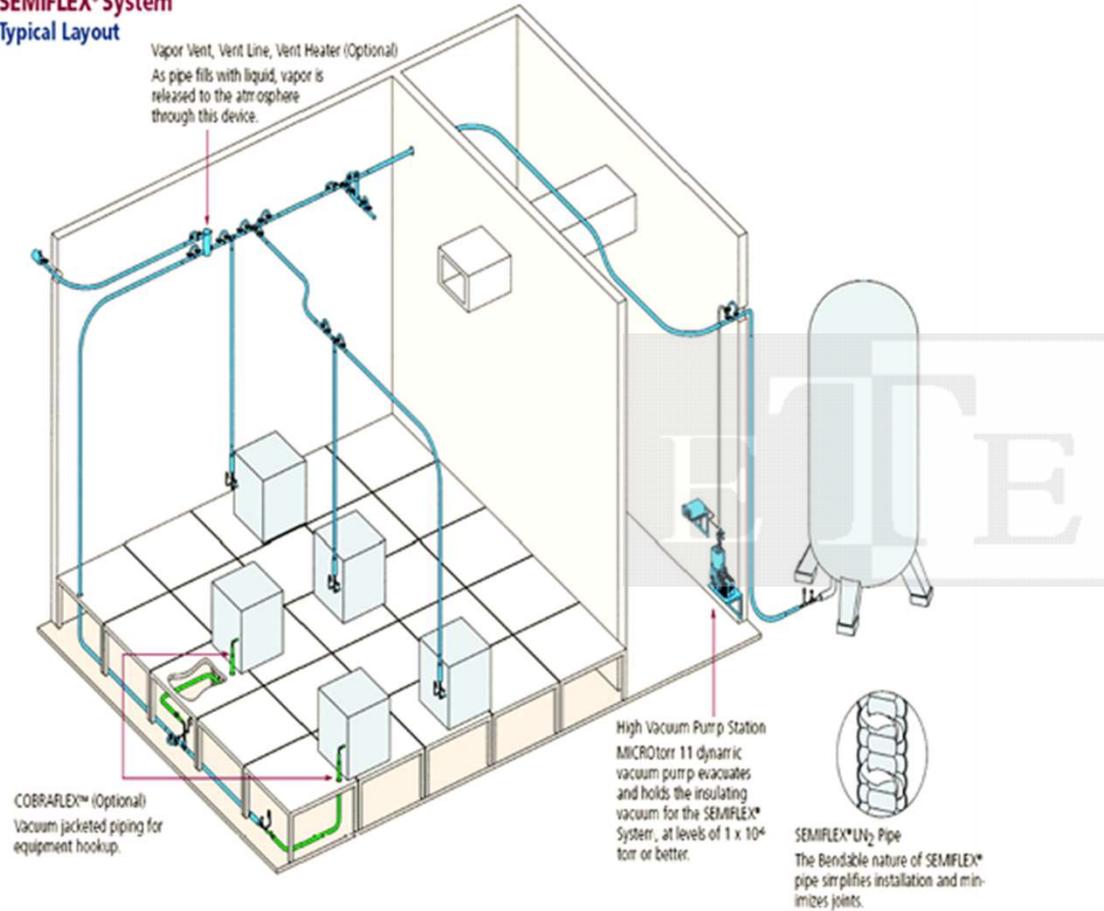
Piping to a typical MBE hook-up



Liquid Vapor Phase Separator

LN₂ (액체질소) Piping System

SEMIFLEX® System Typical Layout



Typical Layout of Semiconductor Test House

03

Appendix

- ❖ 공장 전경
- ❖ 연구소
- ❖ 제조 라인
- ❖ 편의 시설
- ❖ 복리 후생



LOCATION

경기도 화성시 동탄면 동탄산단 2길 7-9

PROFILE

대지 : 4,027m² (1,220평) / 건평 : 3,705m² (3개층 1,122평)

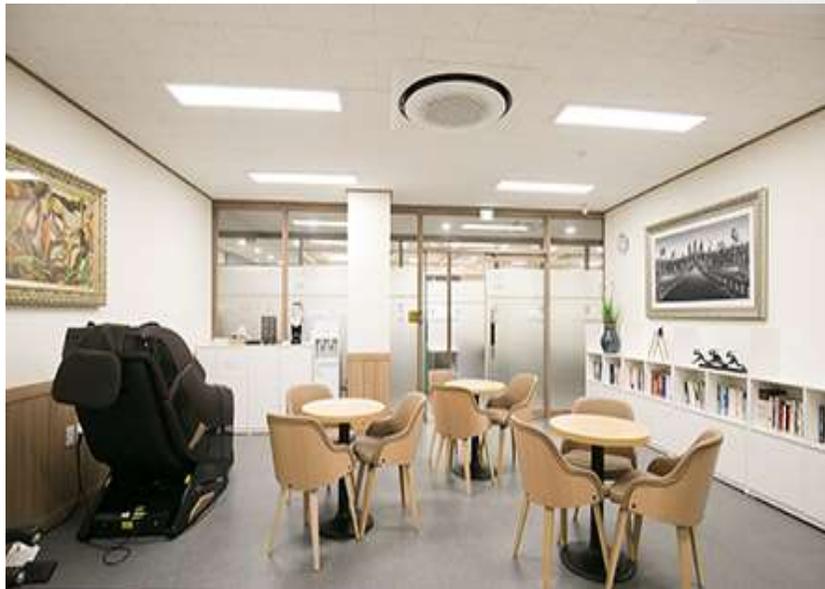
| 연구소(2F)



| 제조 라인(1F)



| 내부 전경(편의시설)



| 복리후생(종합)



워라벨
주 52시간제 준수
자유로운 연차사용



교육
경영인문강좌, 신입사원교육(OJT),
직무능력향상교육,
승진자/MBA/리더십 교육 외



생활
기숙사, 자녀 대학학자금, 각종 경조사지원,
명절/근로자의날/크리스마스 선물



건강
건강검진, 금연 캠페인,
사내 헬스장 운영, 의료비 지원



여가활동
동호회, 문화의 날, 문화공연 관람



수당
식대비 지원, 직책수당, 연구수당 외



정부지원제원
청년내일채움공제, 교통비지원사업,
근로자 휴가지원사업



포상
장기근속자, 인재추천

| 복리후생(건강검진)



◎ 종합 건강검진 (짝수년)

- 대상 및 비용
 - 만40세 미만의 임직원 (40만원)
 - 만40세 이상의 임직원 및 배우자 (각60만원)



◎ 정기 건강검진 (홀수년)

- 대상 및 비용
 - 만40세 이상의 임직원 및 배우자 (각20만원)

- 검진기관 : 필립메디컬센터(분당)
- 검진대상 : 매년 12월 31일 재직자 기준

| 복리후생(우리사주조합)



| 복리후생(청년 내일채움공제)

청년 본인이 2년간 300만원(매월 12만 5천원)을 적립하면
정부(취업지원금 600만원)와 기업(기업기여금 300만원)이 공동 적립
→ 2년 후 만기공제금 1,200만원 + 이자 수령



- 만 15세 ~ 34세 이하의 정규직 근로자
- 정규직 취업일 현재 고용보험 가입이력이 없거나 최종학교 졸업 후 고용보험 총 가입기간이 12개월 이하

| 복리후생 (근로자 휴가지원사업)



➤ 근로자휴가지원사업 참여 ('19년, '20년, '21년)



| 복리후생 (산업단지 중소기업 청년 교통비지원사업)

1. 근로자 만15세~34세
2. 매월 5만원씩 교통비 지원(한도내 바우처 차감방식)
3. 근로자 개인이 개별 신청

